

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他
参与单位	国泰海通、中信建投、中金公司、天风证券、国联民生、西南证券、华安证券、南京证券、国金证券、东兴证券、信达证券、华金证券、中航证券、金融街证券、国盛电子、财通资管、天弘基金、浦银安盛、康曼德、临芯投资、勤晨私募、瑞壹投资、上海歌汝、浙江君弘、武汉美阳、六妙星、万银资产、趋时资产、浙江永禧、驼铃私募、探邨私募、智达信、博成基金、中舍资产、合林私募、豪世资本、中域投资、宁波宝隼、具力资产、高竹私募、瑞特资产。此外，泽壹资本、广熠熠私募、泓杰投资、姚泾河投资、瀚毅信息、时通运泰、顶天投资、浙商大制造、中国东方资产、中银资管、安联保险资管、万润资本、久盈资产、同花顺
活动时间	2026 年 5 月 26 日 2026 年 5 月 28 日 2026 年 5 月 29 日
接待人员	董事会秘书王懿伟、证券事务代表薛连科
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书王懿伟先生介绍公司概况并带领现场参观； 二、董事会秘书王懿伟先生就公司主要产品及相关技术进行介绍； 三、互动环节

Q1 请介绍下公司棱镜项目进展情况？

答：公司开发的半导体工艺键合棱镜，融合了超精密光学冷加工、半导体光刻、光学成膜及棱镜键合等核心技术，可实现光路的多次折叠与高效传输，显著提升手机摄像头的变焦能力与成像质量，目前已经实现量产。同时，公司也正积极向海内外市场拓展该项业务。

Q2 请问公司的玻璃基板业务，有哪些产品，目前是什么进展？

答：公司和日本玻璃厂商合作，开展玻璃基板代加工业务，玻璃基板生产线 2025 年已通过某头部 fab 厂验厂。12 寸玻璃晶圆（Glass Carrier）已批量出货，310*310 和 515*510 等尺寸的玻璃基板小批量出货。但 2025 年半导体用玻璃基板相关的产品销售收入占公司总营收比重 2.00%左右，占比较低，未对公司业绩构成重大影响。

Q3 请问公司 TGV 工艺具备哪些技术能力？

答：公司开发了 TGV 工艺，通过激光诱导与湿法腐蚀在玻璃基材上实现微小孔径（ $\geq 5\mu\text{m}$ ）的通孔及盲孔处理，最大深宽比可达 50:1，孔侧壁 Ra 值 $\leq 80\text{nm}$ 。同时开发了孔内壁镀膜、电镀、CMP 工艺以满足孔内金属化及产品平坦化需求，并利用平面 RDL 布线工艺实现电性互联，形成了完整的 TGV 全流程工艺。

Q4 请问公司有哪些产品可以用在 AI/AR 眼镜？

答：针对 AI/AR 眼镜领域，公司可提供多种零部件产品，包括 MicroLED、高折射率镜片用光学晶圆、光波导片等。其中，8 英寸硅基氮化镓外延 MicroLED 已于 2025 年第四季度开始小批量生产，目前主要应用于 AR 眼镜和车载大灯领域。同时，公司已启动了 MicroLED 全彩方案的研发工作。鉴于 AI/AR 眼镜的未来发展受技术迭代、市场需求等多重因素影响，仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

Q5 请介绍下公司进入三星供应链的情况？

	答：公司通过收购海硕力光电技术（苏州）有限公司和 INNOWAVE VIETNAM CO.,LTD 两家公司 100%股权，已成功切入三星的供应链体系。目前手机摄像模组用软膜滤光片持续量产中，功率芯片的晶圆级封测业务也已进入产品验证。 Q6 请介绍下公司多光谱技术开发情况？ 答：公司与国外 Fabless 厂商合作，采用无机镀膜方案搭配半导体黄光工艺及干法刻蚀工艺，通过区域化刻蚀精准控制膜厚，实现超过 10 个通道的多光谱传感器光路层加工，解决了市场量产方案因不同通道相互重叠导致精度不足等痛点。国内手机客户影像验证结果显示，该方案在自动白平衡（AWB）与真实色彩还原能力上表现优秀，目前产品处于样品认证阶段。 Q7 公司超透镜开发情况怎样？ 答：公司引进了 12 英寸 90nm 节点 KrF 光刻机，用于包括 Metalens 在内的高精度器件研发和加工。公司已开发了包括 PVD 非晶硅、ALD 原子层沉积、百纳米级图形光刻、纳米柱刻蚀及填充、纳米级 CMP 平坦化等在内的 Metalens 工艺。 Q8 公司定增项目当前的最新进展如何？ 答：公司此前公告拟募资不超过 7 亿元，用于“MEMS 器件光学系统制造项目”、“半导体工艺键合棱镜产业化项目”以及补充流动资金。目前定增工作正在有序推进中，公司将根据进展情况及时披露相关信息。 结束
附件清单	无